

実装フェスタ関西2023のご案内

日時：2023年 7/6 (木) ～ 7/7 (金)

場所：パナソニックリゾート大阪

大阪府吹田市青葉丘南10-1 TEL 06-6877-0111

HP：<https://jiep.or.jp/event/workshop/jfk2023/index.php>



関西支部創立20周年記念バージョン

昨年に引き続き活発な議論と人材交流の場としてリアル開催を実施

関西支部創立20周年の祝賀イベントと新たな企画を計画



学生参加の優遇

人材育成と若手技術者交流の観点から
多くの学生さんの参加を期待
学生参加費を従来以上に優遇 (0円～)

スポンサーセッション新設

スポンサー企業の保有する技術や会社を紹介をする
セッションを新設 セッション参加学生には特典
『2日目の昼食クーポン進呈』を準備 (上限あり)

特別講演 7/6 (木) 13:00～14:00

※特別講演のみオンライン形式

「ホリエモンが宇宙開発にみる夢と未来」

堀江 貴文 氏 (SNS media & consulting)

招待講演 7/6 (木) 14:15～16:30

「チップレット時代における半導体パッケージ革命」

「製造業から食サービス事業への挑戦」

「今後の医療技術開発はどうあるべきか」

「感動を生み出すためのハプティクス技術開発」

「ヘテロジニアスインテグレーションに対応したパッケージ基板技術の動向」

「量子コンピュータ最新動向と未来技術」

折井 靖光 氏 (Rapidus)

大野 敦子 氏 (パナソニック)

國友 哲之輔 氏 (公正研究推進協会)

中川 佑輔 氏 (ソニー)

片桐 規貴 氏 (新光電気工業)

藤井 啓祐 氏 (大阪大学)

特別講演 7/6 (木) 16:45～17:30

「CROSS POINT ～分野間コミュニケーション～」

パネリスト 平本 俊郎 氏 (応用物理学会 会長, 東京大学生産技術研究所 教授)

那須 秀行 氏 (JIEP 常任理事, 古河電気工業)

折井 靖光 氏 (JIEP 前副会長, Rapidus 専務執行役員)

齊藤 丈靖 氏 (JIEP 前関西支部長, 大阪公立大学 教授)

ナイトセッション 7/6 (木) 19:45～20:45

招待講演のテーマにて、各講師とグループディスカッション

基調講演 7/7 (金) 11:00～15:15

「半導体産業の川上“結晶”の重要性」

「デジタル&チップ列島改造」

「半導体・デジタル産業戦略について」

森 勇介 氏 (大阪大学)

若林 秀樹 氏 (東京理科大学大学院)

荻野 洋平 氏 (経済産業省 商務情報政策局)

ポスターセッション 48件を予定

第1部 7/7 (金) 9:15~10:45

第2部 7/7 (金) 15:30~17:00

発表	発表者	所属	タイトル
カーエレクトロニクス実装			
1	第1部 大下貴久 氏	テクノアルファ株式会社	チップ毎に個別に加工可能なシタリング装置のご紹介
2	第2部 浅沼博礼 氏	武蔵エンジニアリング株式会社	Advanced Packageに求められる狭ギャップUFを実現する最先端ディスパンス技術
ヘルスケア・ウェアラブル・バイオエレクトロニクス			
3	第1部 福井翔也 氏	公立諏訪東京理科大学	ウェアラブルな小型深部体温計測モジュールの開発
サーマルマネージメント&パワーエレクトロニクス実装			
4	第2部 日高克彦 氏	三菱ケミカル株式会社	カードハウス型BNファイヤーによる超高放熱基板の開発
5	第1部 井手拓哉 氏	株式会社ロータス・サーマル・ソリューション	SiC素子の小型化を実現するロータス銅を用いた熱ソリューション
6	第2部 梁剣波 氏	大阪公立大学	高効率パワー素子の応用に向けたダイヤモンドと3C-SiCの接合技術の研究開発
7	第1部 橋本哲 氏	JFEテクノリサーチ株式会社	異種材料界面剥離につながる熱ひずみの解析 〜デバイスの長寿命化に向かって〜
部品内蔵技術			
8	第2部 田中健太郎 氏	三菱ケミカル株式会社	低誘電エポキシ樹脂の開発状況
プリンタブル・フレキシブルデバイス実装			
9	第1部 三谷雄二 氏	株式会社電気印刷研究所	電気印刷技術の紹介
三次元造形配線・実装応用技術			
10	第2部 河合アラック洋平 氏	早稲田大学	薄膜Au付きCu-Cu接合の接合強度に影響する表面不純物の評価
11	第1部 川村拓史 氏	長岡技術科学大学	金属析出現象を利用したガラス内金属配線技術
12	第2部 渡邊良一 氏	積水化学工業株式会社	高耐熱仮固定テープ セルフ 3DICを実現する耐熱領域仮固定技術
13	第1部 陳少韓 氏	関西大学	無電解めっきバリア上への直接電解CuめっきによるTSV形成技術
材料技術			
14	第2部 椿幸樹 氏	大阪有機化学工業株式会社	ストレッチャブルデバイス用伸縮材料の開発
15	第1部 越智豊 氏	ニホンパダ株式会社	無加圧シンターペーストの接合強度に及ぼす粒子径と表面処理剤の影響
16	第2部 松永知恵 氏	三菱ケミカル株式会社	球状負の熱膨張ファイヤーによるLow-CTE化技術
17	第1部 三ノ上深子 氏	大阪ガスケミカル株式会社	高周波対応 低誘電特性有するフルオレンポリエーテルの開発
18	第2部 水島正博 氏	株式会社シミス	電着塗装法を用いた、金属コア基板の薄型化
19	第1部 紙本葉月 氏	奥野製薬工業株式会社	高屈折率・高透明性を有するジルコニアナノ粒子分散液
20	第2部 吉村凌 氏	三菱ケミカル株式会社	高耐熱性/高機械強度を両立するビスマレイミド樹脂架橋剤の開発
21	第1部 上山椋平 氏	三菱電機株式会社	Pb,Agフリー 高耐熱はんだの接合信頼性評価
22	第2部 岩崎富生 氏	株式会社日立製作所	マテリアルズ・インフォマティクス によるサステナブル複合材料の高信頼設計技術
23	第1部 速水雅仁 氏	パナソニック環境エンジニアリング株式会社	ガラスヘールウェットで処理可能なCuめっきプロセスの工業化
24	第2部 荘司優 氏	東レ株式会社	有機絶縁材料を用いた微細銅配線の絶縁信頼性
電子部品・実装技術			
25	第1部 中亮太 氏	奥野製薬工業株式会社	高い樹脂密着強度を有する粗化銅めっき皮膜
26	第2部 倉科隆之 氏	株式会社きもと	コンパクトコーティング設備でニーズに応える
27	第1部 友利大介 氏	株式会社大陽ソーダ	低温焼結性銀微粒子の無加圧型半導体接合材料への応用
28	第2部 岸本貴臣 氏	田中貴金属工業株式会社	AgSn TLPシートの開発
29	第1部 山岸秀明 氏	株式会社レゾナック	Cu焼結ダイボンド材の開発とサイクル信頼性
30	第2部 糸井清一 氏	パナソニックホールディングス株式会社	インプリント工法による10μmピッチ先鋭マイクロパンプの形成
配線板とその製造技術			
31	第1部 橋本悠衣 氏	豊橋技術科学大学	ガラス・ポリマー基板上Cu層のPdフリー化学的成膜技術
32	第2部 深田和宏 氏	芝浦機械株式会社	中真空PVDによる導体層の形成技術
33	第1部 有本太郎 氏	ウシオ電機株式会社	エキシマランプを用いたVUV照射による表面改質および無電解銅めっきへの応用
34	第2部 清水拓人 氏	日立造船株式会社	日立造船の電子線照射技術と真空成膜技術
35	第1部 清水優 氏	奥野製薬工業株式会社	配線および層間接続ビアの微細化に適した無電解銅めっき技術
高速高周波・電磁特性技術			
36	第2部 大林航太郎 氏	四国化成工業株式会社	密着性向上プロセスGliCAP
光回路実装技術			
37	第1部 吉田航 氏	古河電気工業株式会社	高密度光電インターフェースを用いたCPO向け超小型 VCSELトランシーバ
38	第2部 岡田達弥 氏	東レエンジニアリング株式会社	超極薄(薄膜)チップ転写技術の開発
39	第1部 大曽根華代 氏	京セラ株式会社	ポリマー光導波路基板への電気配線形成技術
環境調和型実装技術			
40	第2部 新田隼也 氏	大阪大学	表面改質ZrO ₂ ナノ粒子を添加したSn-In共晶合金の機械的特性と組織変化
システムインテグレーション実装技術			
41	第1部 浅原颯海 氏	大阪大学	三次元半導体集積回路のハイブリッド接合に向けたデバイスの選択的加熱
マイクロメカトロニクス実装技術			
42	第2部 福田涼太 氏	京都先端科学大学	CuOナノ粒子を用いた積層Ag焼成ダイボンディングにおけるクラック形成メカニズム
43	第1部 三枝大也 氏	京都先端科学大学	Al/Ni瞬間接合におけるポイドとクラックの抑制技術
その他			
44	第2部 中村衣里 氏	クライムプロダクツ株式会社	貼合・積層技術と貼合・積層技術が活かされている業界
45	第1部 金子美泉 氏	日本大学	低温熱源利用のためのMEMS小型発電システム
46	第2部 小澤隆弘 氏	大阪大学接合科学研究所	資源循環ナノ粒子回収に適用可能なマクロ多孔体の開発
47	第1部 古免久弥 氏	大阪大学接合科学研究所	薄板の接合を実現するアークスポット溶接技術の開発
48	第2部 安達佳孝 氏	オムロン株式会社	非接触温度センサのご紹介

JFK2023 スポンサー

ウシオ電機(株), 奥野製薬工業(株), オムロン(株), サンユレック(株), 積水化学工業(株), ソニーセミコンダクタソリューションズ(株), (株)太洋工作所, 東レ(株), 東レエンジニアリング(株), (株)日本スペリア社, 日本電子(株), ボンドテック(株), (株)ロータス・サーマル・ソリューション